

Willkommen bei O-Leading

Lieferant für keramische Leiterplatten

Wir sind professioneller Leiterplattenhersteller mit mehr als zehn Jahren Erfahrung. Einzelne Produktreihe, doppelseitige, mehrschichtige Leiterplatte, flexible Leiterplatte und MCPCB. Wir bieten schnellen Prototypservice - S / S in 24 Stunden, 4-8 Schichten in 48-96 Stunden Produktionszeit.

KUPFERPLATTENLÖCHER MINDEST .025 AVG, .020 MIN. LÖCHER DÜRFEN NICHT GESTROMT WERDEN

Packen Sie mit farbloser, transparenter Luftpolsterfolie, 25 Stck./Tasche, Trockenmittel in die Flanke, setzen Sie die Feuchtigkeitsanzeige auf die Oberseite

BITTE KLICKEN SIE HIER FÜR WEITERE INFORMATIONEN: [Hochwertige keramische Leiterplattenlieferant](#)

Produktbeschreibung

PCB P / N	Q56253-H
Schichtanzahl	2L
Material	FR-4
Board thk	1,60 mm
kupfer thk	1 / 1oz
Kleinste Lochgröße	1,6 mm
Anzahl Löcher (Stück)	668
Impedanzkontrolle J / N (Tol%)	N

O-LEADING
To Be Reliable, To Be Valuable



www.o-leading.com

Unser Team





Zertifizierungen



QUALITY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE
 Certificate No: 16118Q10347R05

We hereby certify that
O-LEADING SUPPLY CHAIN(HK) CO.,LIMITED
 Credit No: 61691591-000-07-17-2
 Registration Add: ROOM 603D 6/F HANG PONT COMMERCIAL BUILDING,31 TONKIN ST,CHEUNG SHA WAN,KL, HK
 Business Add: 1313 Floor 13 Fortune Building, Danstui Town Huiyang District, Huizhou, Guangdong, China

Has implemented and maintains a **Quality Management System**
 Which fulfills the requirements of the following standards
 GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015

Scope of certification
 Sales of printed circuit boards

Initial Issuance period: February 27, 2018
 This certificate is valid during: February 27, 2018 -- February 26, 2021
 This certificate is invalid without CICC qualified label in the following period

First supervision and audit	Qualified mark	Second supervision and audit	Qualified mark
-----------------------------	----------------	------------------------------	----------------

The certification registration scope shall include those production services scope which fall to be covered by the relevant effective administrative permission and qualification permission required by the state. The effectiveness of this certificate shall be evaluated by annual surveillance audit of CICC. The certificate shall be valid when used together with the surveillance audit conclusion. The related information of this certification can be searched at the public website of company www.cicc.com.cn.

201726 201VZL430354 - Wiring, Printed - Component

UL ONLINE CERTIFICATIONS DIRECTORY

ZPMV2.E490354
Wiring, Printed - Component

For enhanced search functionality, please visit UL's [UL Product Databases](#).
 Click on a product designation for complete information.
[Page Bottom](#)

Wiring, Printed - Component

[See General Information for Wiring, Printed - Components](#)

O-LEADING SUPPLY CHAIN CO LIMITED 4190354

Fortune Building, Nanheng West Road
 Room 1313
 Huizhou, Guangdong 516211, CHINA

	Cond Width			SS/ DS/	Area/ Diam	Solder		Diper		Flame	RoHS	C
	Min	Max	Edge			Thk	Limits	Temp	Class			
Typ	max(in)	mm(in)	mic(mil)	DSO	mm(in)	C	sec	C	Class	DSR	I	
Multi-layer (mass laminate) printed wiring boards.												
D-LEADING-401												
	0.2 (0.004)	0.3 (0.012)	34 (1.34)	D6	12.7 (0.5)	260	10	130	V-0	-	-	
D-LEADING-407												
	0.08 (0.003)	0.2 (0.008)	17 (0.67)	D5	9.2 (0.4)	260	10	170	V-0	NI	-	
Multi-layer printed wiring boards.												
D-LEADING-408												
	0.125 (0.005)	0.125 (0.005)	12 (0.47) 31(1.25)	D6	50.8 (2.0)	260	20	130	V-0	NI	*	
Single layer printed wiring boards.												
D-LEADING-002												
	0.76 (0.015)	1.14 (0.045)	34 (1.34)	S5	19.1 (0.8)	260	10	105	V-0	NI	-	
D-LEADING-003												
	0.38 (0.015)	1.14 (0.045)	34 (1.34)	S5	19.1 (0.8)	260	10	130	V-0	▲	-	
D-LEADING-033												
	0.15 (0.006)	0.3 (0.012)	34 (1.34)	S5	25.4 (1.0)	260	10	120	V-0	NI	-	
D-LEADING-205												
	0.1 (0.004)	0.3 (0.012)	34 (1.34)	D6	69.6 (2.7)	260	10	130	V-0	NI	-	
D-LEADING-206												
	0.15 (0.006)	0.33 (0.013)	17 (0.67)	D5	69.6 (2.7)	260	10	130	V-0	NI	-	

* - CTI marking is optional and may be marked on the printed wiring board.

Marking: Company name or file number and type designation. May be followed by a suffix to denote factory identification or burning test classification.
 Last updated on 2017-01-27

Questions? [Print this page](#) [Terms of Use](#) [Page Top](#)

[http://www.ul.com/ulcertification/2017VZL430354/Wiring,Printed-Component](#)



Test Report No. CANEC1805164701 Date: 03 Apr 2018 Page 2 of 8

Test Results:

Test Part Description:

Specimen No. **SGS Sample ID** **Description**
 SN1 CAN18-051647.001 Green "PCB"

Remarks:

- (1) 1 mg/kg = 1 ppm = 0.0001%
- (2) MDL = Method Detection Limit
- (3) ND = Not Detected (< MDL)
- (4) "-" = Not Regulated

RoHS Directive (EU) 2015/863 amending Annex II to Directive 2011/65/EU

Test Method: With reference to IEC 62321-4:2014+A1:2017, IEC 62321-5:2013, IEC 62321-7-2:2017, IEC 62321-6:2015 and IEC 62321-8:2017, analyzed by ICP-OES, UV-Vis and GC-MS.

Test Item(s)	Limit	Unit	MDL	Det
Cadmium (Cd)	100	mg/kg	2	ND
Lead (Pb)	1,000	mg/kg	2	9
Mercury (Hg)	1,000	mg/kg	2	ND
Hexavalent Chromium (CrVI)	1,000	mg/kg	8	ND
Sum of PBBs	1,000	mg/kg	-	ND
Monobromobiphenyl	-	mg/kg	5	ND
Dibromobiphenyl	-	mg/kg	5	ND
Tribromobiphenyl	-	mg/kg	5	ND
Tetrabromobiphenyl	-	mg/kg	5	ND
Pentabromobiphenyl	-	mg/kg	5	ND
Hexabromobiphenyl	-	mg/kg	5	ND
Heptabromobiphenyl	-	mg/kg	5	ND
Octabromobiphenyl	-	mg/kg	5	ND
Nonabromobiphenyl	-	mg/kg	5	ND
Decabromobiphenyl	-	mg/kg	5	ND
Sum of PBDEs	1,000	mg/kg	-	ND
Monobromodiphenyl ether	-	mg/kg	5	ND
Dibromodiphenyl ether	-	mg/kg	5	ND
Tribromodiphenyl ether	-	mg/kg	5	ND
Tetrabromodiphenyl ether	-	mg/kg	5	ND
Pentabromodiphenyl ether	-	mg/kg	5	ND



SGS is pleased to announce the launch of its new online platform for the provision of test results. The platform is designed to provide a secure and efficient way for clients to access their test results. The platform is available in English, French, German, Italian, Japanese, Korean, Spanish, and Chinese. For more information, please contact your local SGS office or visit [www.sgslab.com](#).

Member of the SGS Group (SGS SA)

Verpackung & Lieferung

Verpackungsinformationen	16 Jahre professioneller OEM Leiterplattenhersteller
Lieferungsdetails	7-12days



FAQ

1. Wie sichert O-Leading Qualität?

Unser hoher Qualitätsstandard wird mit folgendem erreicht.

1. Der Prozess wird streng nach ISO 9001: 2008 Standards kontrolliert.
2. Umfassender Einsatz von Software zur Verwaltung des Produktionsprozesses
3. Stand der Technik Testgeräte und Werkzeuge. Z.B. Flying Probe, Röntgeninspektion, AOI (Automated Optical Inspector) und ICT (In-Circuit-Test).
4. engagiertes qualitätssicherungsteam mit fehlerfallanalyseprozess
5. Kontinuierliche Schulung und Schulung des Personals

2. Wie hält O-Leading Ihren Preis wettbewerbsfähig?

Im letzten Jahrzehnt hatten sich die Preise vieler Rohstoffe (z. B. Kupfer, Chemikalien) verdoppelt, verdreifacht oder vervierfacht. Chinesische Währung RMB hatte 31% gegenüber dem US-Dollar aufgewertet; Und unsere Arbeitskosten sind auch deutlich gestiegen. O-Leading hat jedoch unsere Preise stabil gehalten. Dies trägt ganz zu unseren Innovationen bei der Kostenreduzierung, der Vermeidung von Verschwendung und der Verbesserung der Effizienz bei. Unsere Preise sind in der Branche auf dem gleichen Qualitätsniveau sehr wettbewerbsfähig.

Wir glauben an eine Win-Win-Partnerschaft mit unseren Kunden. Unsere Partnerschaft ist für beide

Seiten von Vorteil, wenn wir Ihnen einen Kosten- und Qualitätsvorteil bieten können.

3. Welche Arten von Boards können von O-Leading verarbeitet werden?

Gängige FR4-, High-TG- und halogenfreie Platinen, Rogers, Arlon, Telfon, Platinen auf Aluminium- / Kupferbasis, PI usw.

4. Welche Daten werden für die Leiterplattenproduktion benötigt?

Es ist am besten, Daten im Gerber 274-X-Format bereitzustellen. Darüber hinaus können Cam350, CAD, Protel 99se, PADS, DXP und Eagle verarbeitet werden.

5. Was ist der typische Prozessablauf für mehrschichtige Leiterplatten?

Materialschneiden → Innerer Trockenfilm → Inneres Ätzen → Inneres AOI → Multi-Bond → Schichtstapel Pressen → Bohren → PTH → Plattieren → Äußerer Trockenfilm → Musterplattieren → Äußeres Ätzen → Äußeres AOI → Lötmaske → Bauteilmarkierung → Oberflächenfinish → Routing → E / T → Sichtprüfung.